頎邦科技股份有限公司實習生需求表 (一學年)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 | 頎邦科技股份有限公司 |
| 負責人 | 吳非艱 | 員工人數 | 約4,750人 |
| 聯絡人 | 余珮吟 | 職稱 | 正管理師 |
| 聯絡電話 | 03-5678788 #2316 | E-mail | mandyy@chipbond.com.tw |
| 公司地址 | 新竹市力行五路三號(新竹科學園區) |
| 公司簡介 | 頎邦科技成立於1997年7月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，主要業務為提供顯示器驅動IC後段封裝及測試代工服務，其中驅動IC封裝包括前段之金凸塊製程與後段之TCP及COG封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸塊製作。頎邦科技原在金凸塊的產能位居全球第一大，於2010年4月與飛信進行合併，合併後，包括Wafer test、COF、COG的產能由第二名躍升為全球第一大，成為全球第一大驅動IC封裝公司！我們提供實習生最直接的生產技術訓練，並規劃職涯發展的各項訓練與途徑，讓你在實習階段發覺自己所長，進而結合興趣與專業，持續學習與成長！本公司提供實習生各項福利如下。歡迎你主動爭取實習機會！ |
| 實習期間 | 2016年07月01日 至 2017年06月30日 |
| 實習工作內容 | 名額 | 需求條件或專長 | 是否面談 |
| 生產技術人員-機台操作-利用工具顯微鏡找出產品異常 | 50 | 理工科系或工業工程管理相關科系大四學生對半導體封測產業有興趣者 | ■是□否 |
| 工作內容及特性 | 1. 工作無危險性、若生產線有加班需求則需要配合。
2. 須穿著全套無塵衣，因工作特性需久坐或久站。
3. 日班07:20~19:20；夜班19:20~07:20，固定班別，做四休二或作三休三。
 |
| 薪資 | 日班:月薪2,9600元。(做4休2) 、月薪2,3200元。(做3休3)夜班:月薪3,7300元。(做4休2) 、月薪2,9600元。(做3休3) |
| 福利制度 | 1. 報到第一天即加保勞保、健保、團保，提供完整的工作保障。
2. 提供冷氣宿舍，二人一室每月1500元，前三個月免費(電費另計)。
3. 最高提供實習獎助學金40,000元。
4. 提供公司內部用餐補助、便利商店員工優惠折扣等福利。
5. 獎勵實習生勇敢踏入職場學習，提供獎助學金，並期勉同學能夠儘早取得就業入場券。
6. 鼓勵實習生優良表現，畢業後持續留用頎邦，年資續計並提供高額獎金給予嘉勉。
7. 實習屆滿前，舉辦內部徵選會，協助職涯發展與提供內部轉任機會。
 |